

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04111331 A

(43) Date of publication of application: 13.84.92

(51) Int. CI H01L 21/66
G01R 1/073
G01R 31/26

(21) Application number: 02227889 (71) Applicant: EITO KOGYO:KK

(22) Date of filing: 31.08.90 (72) Inventor:

HIRASHIMA KAZUMASA

TAKAHASHI TATSUMI ISHIKAWA YUJI

(54) JIG FOR INTEGRATED CIRCUIT INSPECTING DEVICE

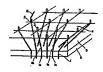
(57) Abstract:

PURPOSE: To ministrative the title ligit tasel so that a purality of jing can be fineed to one wafer and a plurality of integrated circuits can be inspected and purality of integrated circuits can be inspected and purality of integrated circuits can be inspected prize with supporting pieces in insulated states, with the pine being allowed to protrude from the lower surface of the supporting pieces by lengthe nearly equal to their dameters, and insulating the sections connecting the conductive pine with electrode sections connected to an inepocting machine with a glid converting material.

CONSTITUTION: Conductive pins 1 are planted in supporting pieces 2 made of rubber, etc., at the pitch of the conductive pattern A1 of a water A in such a state that the lower sections 1s of the pins 1 are protruded from the lower surfaces of the pieces 2 by length nearly equal to their diameters. A grid converting material 5 which is used for bringing the lower ends of the pins 1 into contact with the pattern A1 transmits the pressure applied to a connector bad 4 from the top to the supporting pieces 2 and, at the same time, has such fleability that the material 5 can cope with the undulation of the pieces 2. Therefore, when a recessure is associated to the connector board 4 from the top to the supporting pieces 2 and 5 to the pieces 2. Therefore, when a recessure is associated to the connector board 4 from the

top while connector pins 3 are connected with lead wires 6, the lower ends of the conductor pins 1 are brought into contact with the conductive pattern A1 of the wafer A.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio





9日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-111331

@Int. CI. 5 H 01 L G 01 R

識別記号 В

庁内整理番号 7013-4M @公開 平成4年(1992)4月13日

9016-2G 8203-2G Ē Ĩ

> 審査請求 請求項の数 1 (全4百)

会発明の名称 集積回路の検査装置用治具

> ②特 頭 平2-227989

> > 達 美

@H 頤 平2(1990)8月31日

@発明者 平 鳥 -- TF 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目7番9号 株式会社エ

@発 明 李 イト工業内

神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目7番9号 株式会社エ イト丁業内

@発 明 者

神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目7番9号 株式会社エ イト工業内

の出 顔 人 株式会社エイト工業 00代 理 人 弁理士 漳野 秀雄

神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目7番9号 外1名

1.発明の名称

集積同路の絵奏装置用治具

2.特許請求の範囲

集積回路の運電パターンに接触する運雷性のビ ンの先端が、下面に突出するように無数に立設さ れていて、ゴム等のような前記導電性のピンの多 少の上下に対応できる程度の柔軟性を有する絶縁 性の支持片と、前紀導電性のピンの植立間隔より も広い間隔で電極が形成されているコネクター部 と、前記導電性のピンと電極とを接続する接続手 段と、抜接統手段を囲繞して支持片とコネクター 部との間に充満し、導電性のピンの上下による支 持片の上下のうねりに対応できる柔軟件のグリッ F 変換材とを備えたことを特徴とする無路回路の 检查等署用治量。

3.発明の詳細な説明

〔座業上の利用分野〕

本発明は、高密度な集積回路のウェハーの中間 検査を行うべく、該ウェハーの運電パターンに、

導電性のピンを接触させ、このピンに接続されて いる検査機によって、この集積回路のウェハーの 検査を行う集積回路の検査装御用治具に関する。 (従来の技術)

從来、集積回路のウェハーの中間検査に用いら れる検査装置においては、該ウェハーの薄電バタ ーンを検査機に接続するために、ウェハーの導電 パターンに接触するプローブ針と称されるピンキ 設けたプローブカードと称される検査治異が用い られていた。

このプローブカードは、中心の窓孔に向かって 放射上に回路パターンがプリントされている基板 の該中心の窓孔にプローブ針の先端を突出させ、 該プローブ針を中心から放射上に配置して基端を 基板の回路パターンに接続したものである。

このプローブカードのプローブ針をウェハーの 上から押しつけるようにして、プローブ針の先輩 をウェハーの厨路パターンに接触させて、ウェハ 一の厚電パターンを検査機に接続して、ウェハー の中間検査を行っていた。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、前記した検査において無視回路は 1 枚のウェハーに参数値が形成されているのに対し 検室治具は単株あるいは 2 個程度を使用して行っ ていた。すなわち、プローブ針はプローブカード に対して放射方向に配置されているため、小さな ウェハーに対して複数値のプローブカードを対向 させることができず、精々 2 個を使用することし かできなかった。

そして、多数個の繁積回路が形成されたウェハーを検索するためには、1つの繁積回路の検差が をサントを後に解接している次の実積回路のペター ンにプローブカードを移動し、また、検索が終す すると次の集積回路に移動するというように減失 検索を連動を行くものである。従って、1つの悪 積固路を検索するに数が同しからないいのは 対値四、1つの集積回路の検案終す後、顕接する の時間が掛かってしまい、全体としての検案時間が 最くなり作業報率が認いという随間かあった。 また、プローブカードのプローブ計の先端は極めて観整化作られ、かつ、互いに接触しないように 酸細な関隔を保っていなければならないが、この プローブ計の接触を防止するためには、プローブ 計の材質の特殊、その保守等の種々の問題が生じ ると共に、このような精密なプローブ針は高低な ものとなり、全体的に高低になってしまうという 即独自もあった。

本発明は前記した問題点を解決せんとするもので、その目的とするところは、治具目体を小型化したことにより、1つのウェハーに対して複数値 を対応させて同時に複数の重積回路の検査を行えるので、検査時間の短縮を図ることができると共に治具の製造および保守が簡単で安価に制作できる無積固路の検査装置用治具を提供せんとするにある。

(課題を解決するための手段)

本発明は、前述の目的を達成するための集積回路の検査装置用治具の手段に関し、集積回路の導電パターンに接触する源電性のピンを、その先端

(発明の実施限)

次に、本発明の第1の実施例を、第1図につい て説明する。

1 は導電性のピンで、ゴム等の支持片 2 に、そ の下部 1 a を、その直径と略同一長さだけ突出さ せて、複立されている。

この薄電性のピン1は、ウェハーの回路と集積 回路の端子とを接続するボンディングワイヤが接 続されるウェハーAの薄電パターンA1と同一ピ ァチとするために、その直径は50~100ミク ロン程度の綴さで、ウェハーAの導電パターンA 1のピッチに合わせて植立される。

そして、この導電性のピン1の下端がウェハー Aの導電パターンA1に接触するものである。

前記、支持片とは運電性のピン1の下端を、ウェハーAの導電パターンに接触させるペイ、上から圧力を加えた際に、ウェハーAの電電パターンが多少上下に戻っていても、全部の導電性のピン1の下端がこれに接触できる程度に距曲できる柔軟性をもたされている。

3 はコネクターピンで、検査機に接続するリー ド線6 を巻付ける等の接続手段をとることができ る程度の間隔で、コネクター版4に値立されてい る。

導電性のピン1の上部16は、支持片2の上面 から適宜の長さが突出されていて、この上部16 を屈曲させて前記コネクターピン3に接続している。

前記支持片 2 とコネクター板 4 との間隔は、1

/2~1インチ程度の間隔に保たれ、この間には 導電性のピン1の上部1bを開鍵してグリッド変 地は5が支援されている

このグリッド要換材さは、陽電性のピン1の下端でウェハー人の思電パクーン人1に接触させる べく、コネクター版4に上から圧を加えた際の 圧力を、支持片2に近えると共に、暴電性のピン 1の多少の上下によって生ずる支持片2のうねり に対応してこれを吸収できる程度の柔軟性をもっ ている。

従って、コネクターピン3に検変機からのリード線6を接続しておき、コネクター仮4の上から 圧力を加えれば、支持片1の要軟性により、第2 匠の状態であった電電性のピン1は、第3間のように支持片2が演曲することにより、全部の事電性のピン1の下端と、ウェハーAの薄電パターン A1の起てに、接触させることができるものである。

る。 次に、本発明の第2の実施例を、第4図について説明する。 この実施例は、前実施例に対してコネクター版 4を設けることなく、グリッド材5の上面に、直接に平面電極7を形成し、これに前実施例と同様 に運電性のピン1の上部1bを接続する。

・そして、この平断電腦7に検実機からのリード 減の光端のコネクタービン8をヘンダ付けしたり、 或いは平断電筒に接続用のビンをヘンダ付けして、これに検支機からのリード線を巻き付ける等 の手段で、検索機と平断電極7とを接続するもの ****

本実施例のその他の部分は、前実施例と変わる ものではない。

更に、本発明の第3の実施例を、第5図について説明する。

この実施例においては、厚電性のピン1は、支 持片2の上版には突出させず、支持片2の上版に は厚電性のピン1に接続されていて、厚電位の ン1よりは僅かに大きい平面電極3が形成される。 そして、コネクターピン3とコネクター仮ピン 11の実施料に関ビに新版され、コネクターはは

3と平面電極 9 とは、ボンディングワイヤ 1 0 で接続される。

支持片2とコネクター板4との間には、第1の 実施例と同様に、ボンディングワイサ10を囲焼 してグリッド変換材5が充壌されるもので、この グリッド変換材5は、第1の実施例と同様な働き をするものである。

その他、本発明においては、検査機と導電性の ビン1とを接続するコネクター部分は、前記実施 例に示した手段以外にも、種々の方法が利用でき るものである。

(発明の効果)

本発明は収上のように、 深電性のビンは支持片で絶縁されて支持され、その直径程度にしか支持 片の下間に突出しておらず、且つ税金限に接続する電極的分と変性的でがあって、深電性のビンとを接対する部分も、 グリッド変換材で絶縁されているので、深電性の ビン同士が関端するおされかなく、しかも、小型 化が可能なので、1つのウェハーに対して複数間 を対応させて同時に複数の乗機関路の検金を行え、 従って、検査時間の短縮を図ることができると共 に導電性のピンの材質や、その短緒の監視や保守 の困難さがなくなり、しかも支持片への植立も容 裏であるため、産価に提供できる。

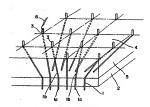
又、属電性のピンのピッチが従うことがなく、 且つ電電性のピンはウェハーの馬電パターンだ多 少の上下の反うがあっても、支持片の柔軟性によ すて、馬電性のピンの先端を上下し、絵での暴電 性のピンの先端をウェハーの馬電パターンに接触 させることができるので、セット時間を短縮する ことが可能となり、検査効率の向上が図れる等の 効果を有するものである。

4. 図面の簡単な説明)

第1回は本発明の第1の実施例の斜面図、 第2回は享電性のピンとウェハーとが離れてい る場合の側面図、

第3回は同上の接触状態の側面図、

第4回は第2の実施例の要部の斜面図、 第5回は第3の実施例の要部の斜面図である。 1…導電性のピン、2…支持片、3…コネクタ ーピン、4 …コネクター板、5 … グリッド材、7 。 9 …平面電板、10 …ポンディングワイヤ、A … ウェハー、A 1 …薄電パターン。



特許出願人

株式会社エイト工業

代 理 人

准野 秀姓色

8

. - 6

第1日



第2図



第3日



第 4 [



-190-